

HyFlo 阀

中到高粘度及磨料的高容量/流速点胶技术

在要求高产量或高粘度材料下，需要特别的点胶阀以达到这个要求。HyFlo 点胶阀是在高粘度及磨料且高流速的要求下而设计。

HyFlo 阀的设计有大直径，积极进取，电石双螺旋以解决磨料流体。根据容量的要求，有着不同螺旋槽的深度，及螺旋随时可以互换。对于磨粒填料的应用，螺旋可以定制以避免螺旋绑定，剪切，和磨损。定制包含分析填充物的大小，适当的螺旋直径缩小，以适应填料。



螺旋是由高转速马达旋转和编码器精确控制。如果点胶线或区域填充类型，阀的编程通过阀的转速编码器计数/秒。在点一点胶，被定为计数的数量。

当流体的粘度超过100,000cps，建议使用高扭力马达。齿轮箱增加扭力，允许它毫不费力地通过厚流体旋转。可选的加热器有助于减少一些流体的粘度。



流体由电脑控制的空气压力输送到螺旋墨盒。精确的自动控制，准确提供流体至墨盒，确定不超过或低于所须的气压。流体透过精密喷嘴传递到基板，设计为最大流量的喷嘴。在喷嘴入口处，超过正常直径抓住流体并通过指定长度的管直到所需的ID。这种设计大大降低了压力累积和提高流量。喷嘴大小在13G开始，且提供其他普遍的喷嘴。

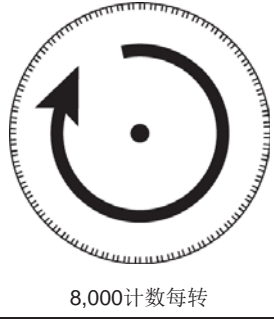
清洗HyFlo阀非常容易。螺旋盒组件以拇指螺丝和简单的杠杆装在泵内。一旦螺旋和墨盒已卸下并拆卸，可以很方便地清洗两部分，与传统的清洗用品，或放置在一个超声波清洗机。



阀/泵 控制技术

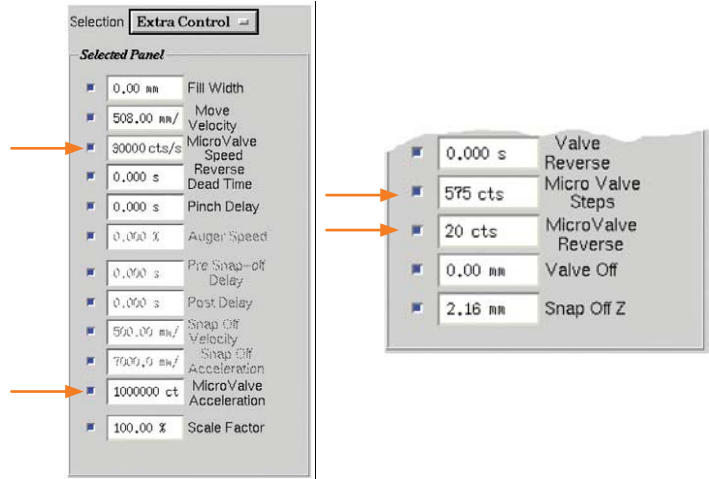
阀动作通过 **FLoware®** 软件控制

- 阀配备了8000旋转编码器计数
- 允许精确控制螺旋螺杆的转动动作



FLoware® 软件控制阀的各个方面动作

- 加速和减速
- 转速通过计数/秒



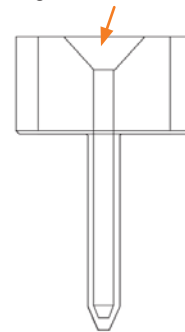
许多针头大小和类型以提供特定的点胶要求

- 精密圆锥喷嘴，给于低材料的针表面张力
- 修身剪裁喷嘴技巧减少在底部填充时管芯或CSP的距离
- 针设有大，固定材料路径的直径以增强点胶能力



HyFlow 针头

High Flow 材料通路



最后点胶直径仅在尖端